

# 8 位微控制器 HR6P77

# 数据手册

- □ 产品简介
- ☑ 数据手册(简化资料)
- □ 产品规格(详尽资料)

上海海尔集成电路有限公司

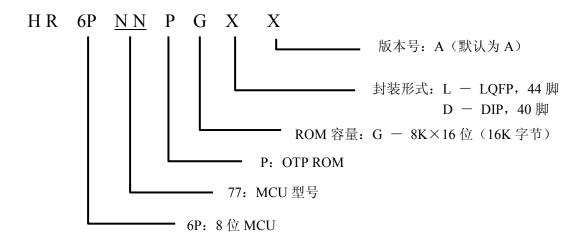
2008年4月15日

1/26



## 产品订购信息

型号	ROM	RAM	封装
HR6P77PGL	8K×16 位	384×8 位	LQFP44
HR6P77PGD	8K <10 位.	384~8 位	DIP40



地址:中国上海市中山南二路 1089 号徐汇苑大厦 15 楼

邮编: 200030

E-mail: sales@ichaier.com, fae@ichaier.com

电话: +86-21-64572211 传真: +86-21-64572618 网址: http://www.ichaier.com/

#### 版权所有

## 上海海尔集成电路有限公司

本数据手册的信息在发行时是经过核实并且尽最大努力使之精确的。上海海尔集成电路有限公司不为由于使用本数据手册而可能带来的风险或后果负责。规格中的实例仅作为说明用途,上海海尔集成电路有限公司不担保或确认这些实例是合适的、不需进一步修改的、或推荐使用的。上海海尔集成电路有限公司保留不需要通知本数据手册读者而修改自己产品的权利。如需得到最新的产品信息,请随时用上述联系方式与上海海尔集成电路有限公司联系。

电话: +86-21-64572211 网址: http://www.ichaier.com/



# 目 录

1.	芯片概述	4
2.	芯片特性	4
	3. 1 结构框图	6
	3. 2 芯片管脚图	7
	3. 3 芯片管脚说明	8
4.	存储器	10
	4. 1 程序存储器	10
	4. 2 数据存储器	10
5.	定时器/计数器	14
	5. 1 TIMER0 模块	14
	5. 2 TIMER1 模块	14
	5. 3 TIMER2 模块	14
6.	CCP(捕捉/比较/脉宽调制)模块	14
7.	模/数转换器ADC 模块	14
8.	高速同步/异步接收发送器模块HUSART	
9.	指令集系统	15
10.	CPU特性	17
	10. 1 低功耗休眠IDLE状态	17
	10.2 中断逻辑	17
	10. 3 复位	18
11.	DC参数特性	19
12.	AC参数特性	25
	12. 1 时钟要求	25
	12. 2 ADC交流特性	25
12	苯比科苯	26

3/26



## 1. 芯片概述

本芯片内核采用两级流水线,是哈佛型结构的精简指令CPU。在这种结构中,程序和数据存取的总线是相互独立的。指令存储体数据字宽为16位,大多数指令能在一个机器周期内执行完毕,所有指令都是单字指令。指令集为48条,编码效率高,容易进行指令扩展。芯片集成了众多片内外设,如:模拟/数字转换电路,硬件看门狗,一个8位定时/计数器,一个16位定时/计数器,一个8位定时器,两路CCP(捕获/比较/脉宽调制)模块,高速串行外围接口HSPI模块,高速芯片间总线HIIC方式模块,HUSART高速同步/异步接收发送器模块,低电压检测及低电压复位模块等。

通用数据寄存器采用单端口、异步低功耗SRAM,存储深度为384×8位。程序存储器存储深度为8K×16位。

## 2. 芯片特性

#### ◆ CPU

- ◇ 高性能的RISC CPU内核
- ◇ 仅48条精简指令
- ◇ 支持中断处理,14个中断源

#### ◆ 指令

- ◇ 工作频率为DC~16MHz,一个机器周期为4个时钟周期
- ◇ 部分程序跳转指令需要两个机器周期,其余指令都是一个机器周期

#### ◆ 存储器

- ◇ 8级硬件堆栈结构
- ◇ 直接、间接和相对寻址三种方式
- ◇ 8K×16位的程序存储器
- ◇ 384字节的数据存储器,分为存储体组0、存储体组1、存储体组2和存储体组3四个存储体组
- ◇ 复位向量位于0000<sub>H</sub>, 中断向量位于0004<sub>H</sub>、000D<sub>H</sub>和0021<sub>H</sub>

#### ◆ 特殊功能

- ◇ 内嵌上电复位电路
- ◇ 低电压检测及低电压复位
- ◇ 支持硬件看门狗
- ◇ 支持编程代码保护
- ◇ 低功耗休眠方式

#### ◆ 设计及工艺

- ◇ 完全静态设计
- ◇ 低功耗、高速OTP CMOS工艺
- ◇ 33个I/O引脚,采用LQFP44/DIP40封装

电话: +86-21-64572211 网址: http://www.ichaier.com/



## ◆ 定时器/计数器

◇ TIMER0: 带有8位预分频器的8位定时器/计数器

◇ TIMER1: 带有预分频器的16位定时器/计数器

◇ TIMER2: 带有8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器

## ◆ 通信接口

- ◇ 高速同步串行通信口HSPI
- ◇ 高速芯片间总线 HIIC 方式
- ◇ 高速同步/异步接收发送器 HUSART
- ◇ 并行从动口 PSP

## ◆ 其他外设

- ◇ 两路CCP: 捕捉器/比较器/脉宽调制器模块
- ◇ ADC: 8通道8位模拟/数字转换器

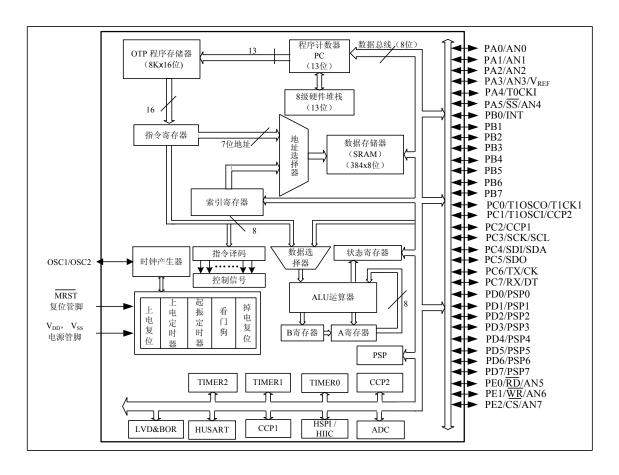
## ◆ 工作条件

- ◇ 工作电压范围: 3.5V~5.5V
- ◇ 工作温度范围: -40~85℃

网址: http://www.ichaier.com/



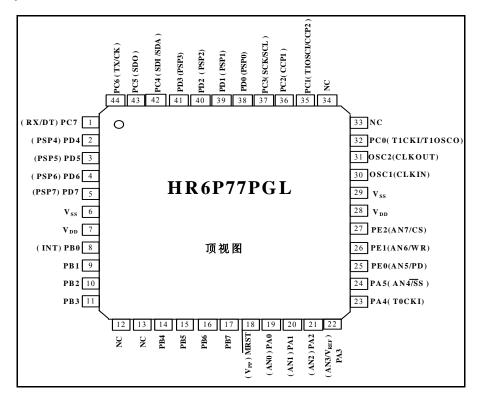
#### 3. 1 结构框图



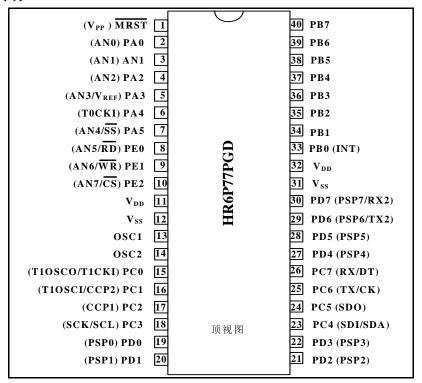


#### 3. 2 芯片管脚图

#### 44 脚 LQFP 封装



#### 40 脚 DIP 封装





# 3. 3 芯片管脚说明

管肺	<b>却号</b>			lect v. l. mn			
HR6P77	HR6P77	管脚名	I/O	缓冲器 类型	管脚说明		
PGD	PGL			<b>安</b> 堡			
1	18	MRST /V <sub>PP</sub>	I	_	主复位信号,复用 OTP 编程高压		
12, 31	6, 29	V <sub>SS</sub>	P	_	地, 0V 参考点		
11, 32	7,28	$V_{DD}$	P	_	电源		
13	30	OSC1	I	CMOS	振荡器输入端口		
14	31	OSC2	О	_	振荡器输出端口		
_	12, 13, 33, 34	NC	_	_	空端口		
2	19	PA0/AN0			PA 是双向输入输出端口;		
3	20	PA1/AN1			PA4也作为TIMER0模块的时钟输入端		
4	21	PA2/AN2		TTL	口; PA5 也作为同步串行口的选择输入		
5	22	PA3/AN3/V <sub>REF</sub>	I/O	SMT	端口; PA0 ~ PA3、PA5 也作为模拟信		
6	23	PA4//T0CKI			号的输入端口; PA3 也作为 ADC 外部		
7	24	PA5/AN4/SS			参考电压端口。		
33	8	PB0/INT					
34	9	PB1					
35	10	PB2			PB 是双向输入输出端口,所有输入端		
36	11	PB3	1/0	TTL	口都有软件可编程弱上拉; PB0 也可作		
37	14	PB4	I/O	SMT	为外部中断输入端口; PB4~PB7端口		
38	15	PB5			电平变化可产生中断请求。		
39	16	PB6					
40	17	PB7					
15	32	PC0/T1OSCO/T1 CKI			PC 是双向输入输出端口; PC0 也作为 TIMER1 时钟输入端口, TIMER1 振荡		
16	35	PC1/T1OSCI/CC P2			器输出; PC1 也作为捕捉功能 2 输入/ 比较功能 2 输出/PWM2 输出端口,		
17	36	PC2/CCP1			TIMER1 振荡器输入; PC2 也作为捕捉		
18	37	PC3/SCK/SCL		TTL	功能 1 输入/比较功能 1 输出/PWM1 输		
23	42	PC4/SDI/SDA	I/O SMT		出端口; PC3 也作为 HSPI 和 HIIC 的时		
24	43	PC5/SDO			钟输入输出端口; PC4 也作为 HSPI 数		
25	44	PC6/TX/CK			据输入端口和 HIIC 的数据输入输出端口; PC5 也作为 HSPI 的数据输出端口;		
26	1	PC7/RX/DT			PC6 也作为 HSCI 异步发送或同步时钟 通信端口; PC7 也作为 HSCI 异步接收 或同步数据通信端口。		

8/26

网址: http://www.ichaier.com/



## 【续】

引馬	<b>却号</b>			缓冲器	
HR6P77	HR6P77	引脚名	I/O	类型 类型	引脚说明
PGD	PGL			<b>7</b> , <u> </u>	
19	38	PD0/PSP0			
20	39	PD1/PSP1			
21	40	PD2/PSP2			
22	41	PD3/PSP3	I/O	TTL SMT	PD 是双向输入输出端口,同时也
27	2	PD4/PSP4	1/0	TTL SMIT	是并行通信数据端口。
28	3	PD5/PSP5			
29	4	PD6/PSP6			
30	5	PD7/PSP7			
8	25	PE0/CS/AN5			PE 是双向输入输出端口; PE0 是
9	26	PE1/RD/AN6	I/O	TTL SMT	并行通信片选端口; PE1 是并行通信读控制端口; PE2 是并行通
10	27	PE2/WR/AN7	1/0	1120111	信写控制端口; PE 也是模拟输入口。

注: I = 输入, O = 输出, P = 电源/地, TTL = TTL 输入, SMT = 施密特触发器输入。



#### 4. 存储器

存储器由程序存储器和数据存储器组成,数据存储器与程序存储器相互独立。其中程序存储器为 8K×16 位 OTP 存储器;数据存储器中特殊功能寄存器为 96×8 位,通用数据寄存器为 384×8 位。通用数据寄存器采用单端口、异步低功耗 SRAM 实现。

#### 4.1 程序存储器

本芯片的程序计数器PC为 13 位字宽,可寻址空间为 8K,地址范围为  $0000_{H} \sim 1 FFF_{H}$ ,寻址超出  $1 FFF_{H}$ 就会导致循环。复位向量位于  $0000_{H}$ ,中断向量入口地址位于  $0004_{H}$ 、 $000D_{H}$  和  $0021_{H}$ 。

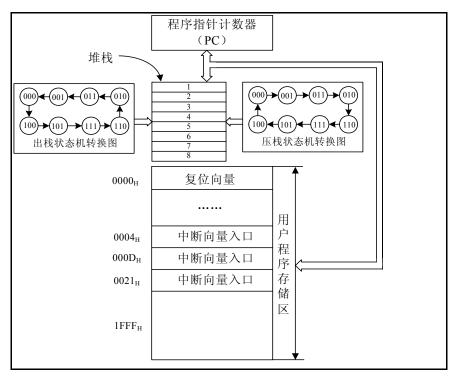


图 4.1 程序存储器映射和堆栈示意图

#### 4. 2 数据存储器

数据存储器按照功能划分为通用数据寄存器 (384 字节) 和特殊功能寄存器 (96 字节),数据存储器分为四个存储体。每个存储体组包括 128 字节存储空间,存储体组 0 和存储体组 1 分别包括 96 字节通用数据寄存器存储空间和 32 字节特殊寄存器;存储体组 2 和存储体组 3 分别包括 112 字节通用数据寄存器存储空间和 16 字节特殊寄存器。部分通用数据寄存器存储空间被映射到相同的通用数据寄存器单元。数据存储器地址有两种映射方式,映射方式的选择由芯片配置字 SMAP 位决定,数据存储器在不同地址映射方式下的地址分配参见表 4.1 和表 4.2。

数据存储器的寻址可以采用直接寻址和间接寻址。直接寻址是通过指令码中的操作数直接寻址,间接寻址是通过索引寄存器 FSR 来寻址,即索引寄存器 FSR 内保存的数据为被间接寻址寄存器的地址,而被间接寻址的寄存器数据通过对 INDF 寄存器的读写操作获得。

网址: http://www.ichaier.com/



地址	寄存器名称	地址	寄存器名称	地址	寄存器名称	地址	寄存器名称
$000_{\rm H}$	INDF	$080_{\rm H}$	INDF	100 <sub>H</sub>	INDF	180 <sub>H</sub>	INDF
001 <sub>H</sub>	TIMER0	081 <sub>H</sub>	OPTION_REG	101 <sub>H</sub>	TIMER0	181 <sub>H</sub>	OPTION_REG
002 <sub>H</sub>	PCL	082 <sub>H</sub>	PCL	102 <sub>H</sub>	PCL	182 <sub>H</sub>	PCL
003 <sub>H</sub>	STATUS	083 <sub>H</sub>	STATUS	103 <sub>H</sub>	STATUS	183 <sub>H</sub>	STATUS
$004_{\rm H}$	FSR	084 <sub>H</sub>	FSR	104 <sub>H</sub>	FSR	184 <sub>H</sub>	FSR
$005_{\mathrm{H}}$	PA	085 <sub>H</sub>	PACTR	105 <sub>H</sub>	未用	185 <sub>H</sub>	未用
$006_{\rm H}$	PB	086 <sub>H</sub>	PBCTR	106 <sub>H</sub>	PB	186 <sub>H</sub>	PBCTR
$007_{\rm H}$	PC	087 <sub>H</sub>	PCCTR	$107_{\rm H}$	未用	$187_{\rm H}$	未用
$008_{\mathrm{H}}$	PD	088 <sub>H</sub>	PDCTR	108 <sub>H</sub>	未用	188 <sub>H</sub>	未用
$009_{\rm H}$	PE	089 <sub>H</sub>	PECTR	109 <sub>H</sub>	未用	189 <sub>H</sub>	未用
$00A_{\rm H}$	PCLATH	08A <sub>H</sub>	PCLATH	10A <sub>H</sub>	PCLATH	18A <sub>H</sub>	PCLATH
$00B_{\mathrm{H}}$	INTCON	$08B_{H}$	INTCON	$10B_{\rm H}$	INTCON	$18B_{\rm H}$	INTCON
$00C_{\rm H}$	PIR1	08C <sub>H</sub>	PIE1	10C <sub>H</sub>	未用	18C <sub>H</sub>	未用
$00D_{\rm H}$	PIR2	$08D_{\rm H}$	PIE2	$10D_{\rm H}$	未用	$18D_{\rm H}$	未用
$00E_{\rm H}$	TIMER1L	$08E_{\rm H}$	PCON	$10E_{\rm H}$	未用	$18E_{\rm H}$	未用
$00F_{\rm H}$	TIMER1H	$08F_{\rm H}$	INTCTR	$10F_{\rm H}$	未用	$18F_{\rm H}$	未用
$010_{\rm H}$	T1CON	$090_{\rm H}$	BORPR				
$011_{\rm H}$	TIMER2	$091_{\rm H}$	BORCON				
012 <sub>H</sub>	T2CON	092 <sub>H</sub>	PR2				
$013_{\rm H}$	SPIBUF	093 <sub>H</sub>	SSPADD				
$014_{\rm H}$	SPICON	094 <sub>H</sub>	SPISTAT				
$015_{\rm H}$	CCP1L	095 <sub>H</sub>	未用				
$016_{\rm H}$	CCP1H	096 <sub>H</sub>	未用	110		100	
$017_{\rm H}$	CCP1CON	097 <sub>H</sub>	未用	110 <sub>H</sub> ∼	未用	190 <sub>H</sub> ∼	未用
$018_{\rm H}$	RCSTA	098 <sub>H</sub>	TXSTA	~ 11F <sub>H</sub>		~ 19F <sub>H</sub>	
019 <sub>H</sub>	TXREG	099 <sub>H</sub>	SPBRG	111 Н		171 H	
$01A_{\rm H}$	RCREG	09A <sub>H</sub>	未用				
$01B_{\rm H}$	CCP2L	$09B_{H}$	未用				
$01C_{\rm H}$	ССР2Н	09C <sub>H</sub>	未用				
$01D_{\rm H}$	CCP2CON	09D <sub>H</sub>	未用				
01E <sub>H</sub>	ADRES	09E <sub>H</sub>	未用				
01F <sub>H</sub>	ADCON0	09F <sub>H</sub>	ADCON1				
$020_{\mathrm{H}}$	通用数据寄	$0A0_{H}$		120 <sub>H</sub>	通用数据寄	$1A0_{H}$	
~	存器区	~	通用数据寄存器区	~	存器区	~	通用数据寄存器区
$07F_{\rm H}$	11 地址	$0FF_{H}$		$17F_{\rm H}$	11 地区	$1FF_{H}$	

表 4.1 数据存储器地址映射方式 1

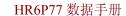
电话: +86-21-64572211 网址: http://www.ichaier.com/



地址	寄存器名称	地址	寄存器名称	地址	寄存器名称	地址	寄存器名称
$000_{\mathrm{H}}$	INDF	$080_{\rm H}$	INDF	100 <sub>H</sub>	INDF	180 <sub>H</sub>	INDF
$001_{\mathrm{H}}$	TIMER0	081 <sub>H</sub>	OPTION_REG	$101_{\rm H}$	TIMER0	181 <sub>H</sub>	OPTION_REG
$002_{\rm H}$	PCL	082 <sub>H</sub>	PCL	102 <sub>H</sub>	PCL	182 <sub>H</sub>	PCL
003 <sub>H</sub>	STATUS	$083_{\rm H}$	STATUS	103 <sub>H</sub>	STATUS	183 <sub>H</sub>	STATUS
004 <sub>H</sub>	FSR	084 <sub>H</sub>	FSR	104 <sub>H</sub>	FSR	184 <sub>H</sub>	FSR
005 <sub>H</sub>	PA	085 <sub>H</sub>	PACTR	105 <sub>H</sub>	未用	185 <sub>H</sub>	未用
$006_{\rm H}$	PB	086 <sub>H</sub>	PBCTR	106 <sub>H</sub>	PB	186 <sub>H</sub>	PBCTR
$007_{\mathrm{H}}$	PC	087 <sub>H</sub>	PCCTR	107 <sub>H</sub>	未用	187 <sub>H</sub>	未用
008 <sub>H</sub>	PD	088 <sub>H</sub>	PDCTR	108 <sub>H</sub>	未用	188 <sub>H</sub>	未用
009 <sub>H</sub>	PE	089 <sub>H</sub>	PECTR	109 <sub>H</sub>	未用	189 <sub>H</sub>	未用
00A <sub>H</sub>	PCLATH	08A <sub>H</sub>	PCLATH	10A <sub>H</sub>	PCLATH	18A <sub>H</sub>	PCLATH
$00B_{\rm H}$	INTCON	$08B_{\rm H}$	INTCON	$10B_{\rm H}$	INTCON	18B <sub>H</sub>	INTCON
$00C_{\rm H}$	PIR1	$08C_{\rm H}$	PIE1	10C <sub>H</sub>	未用	18C <sub>H</sub>	未用
$00D_{\rm H}$	PIR2	$08D_{\rm H}$	PIE2	$10D_{\rm H}$	未用	$18D_{\rm H}$	未用
$00E_{\rm H}$	TIMER1L	$08E_{\rm H}$	PCON	10E <sub>H</sub>	未用	18E <sub>H</sub>	未用
$00F_{\rm H}$	TIMER1H	$08F_{\rm H}$	INTCTR	10F <sub>H</sub>	未用	$18F_{\rm H}$	未用
$010_{\rm H}$	T1CON	$090_{\rm H}$	BORPR	$110_{\rm H}$		190 <sub>H</sub>	
$011_{\rm H}$	TIMER2	$091_{\rm H}$	BORCON	$111_{\mathrm{H}}$		191 <sub>H</sub>	
012 <sub>H</sub>	T2CON	092 <sub>H</sub>	PR2	112 <sub>H</sub>		192 <sub>H</sub>	
$013_{\rm H}$	SPIBUF	$093_{\rm H}$	SSPADD	113 <sub>H</sub>		193 <sub>H</sub>	
$014_{\rm H}$	SPICON	$094_{\rm H}$	SPISTAT	114 <sub>H</sub>		194 <sub>H</sub>	
$015_{\mathrm{H}}$	CCP1L	095 <sub>H</sub>	未用	115 <sub>H</sub>		195 <sub>H</sub>	
$016_{\rm H}$	ССР1Н	096 <sub>H</sub>	未用	116 <sub>H</sub>		196 <sub>H</sub>	
$017_{\rm H}$	CCP1CON	$097_{\rm H}$	未用	$117_{\rm H}$	通用数据寄存	197 <sub>H</sub>	通用数据寄存器
$018_{\rm H}$	RCSTA	$098_{\rm H}$	TXSTA	118 <sub>H</sub>	器区	198 <sub>H</sub>	$\boxtimes$
$019_{\rm H}$	TXREG	$099_{\rm H}$	SPBRG	119 <sub>H</sub>		199 <sub>H</sub>	
$01A_{H}$	RCREG	09A <sub>H</sub>	未用	$11A_{\rm H}$		19A <sub>H</sub>	
$01B_{H}$	CCP2L	$09B_{H}$	未用	$11B_{\rm H}$		19B <sub>H</sub>	
01C <sub>H</sub>	ССР2Н	09C <sub>H</sub>	未用	11C <sub>H</sub>		19C <sub>H</sub>	
$01D_{H}$	CCP2CON	09D <sub>H</sub>	未用	11D <sub>H</sub>		19D <sub>H</sub>	
$01E_{\rm H}$	ADRES	$09E_{\rm H}$	未用	11E <sub>H</sub>		19E <sub>H</sub>	
$01F_{\rm H}$	ADCON0	09F <sub>H</sub>	ADCON1	11F <sub>H</sub>		19F <sub>H</sub>	
		$0A0_{H} \sim$	通用数据寄存器	120 <sub>H</sub> ~	通用数据寄存	$1A0_{H} \sim$	通用数据寄存器
020 <sub>H</sub> ~	通用数据寄存	$0EF_{H}$	X	16F <sub>H</sub>	器区	1EF <sub>H</sub>	X
$07F_{\rm H}$	器区	$0F0_{H}$	映射到与 070 <sub>H</sub> ~	$170_{\mathrm{H}}$	映射到与070 <sub>H</sub>	$1F0_{H}$	映射到与 070 <sub>H</sub>
- / - n	nn	~	07F <sub>H</sub> 相同的物理	~	~07F <sub>H</sub> 相同的	~	~07F <sub>H</sub> 相同的物
		$0FF_{H}$	地址	$17F_{\rm H}$	物理地址	$1FF_{H}$	理地址

表 4.2 数据存储器地址映射方式 2

电话: +86-21-64572211 网址: http://www.ichaier.com/





注:数据存储器地址映射方式 1 情况下,有 384 个通用数据寄存器可用;地址映射方式 2 情况下,由于部分通用数据寄存器存储空间被映射到相同的通用数据寄存器单元,只有 368 个通用数据寄存器可用。数据寄存器地址映射方式可通过芯片配置的 SMAP 位选择。



### 5. 定时器/计数器

## 5. 1 TIMER0 模块

TIMER0 是一个 8 位可读写的定时器/计数器, CPU 可对 TIMER0 寄存器进行读写操作。TIMER0 与 WDT 共用一个 8 位的可编程预分频器。TIMER0 的计数值存放在 TIMER0 寄存器中, 休眠模式下将停止计数。TIMER0 的递增可由内部或外部的时钟来触发。

通常情况下,使用内部时钟时称之为定时器模式(Timer Mode),使用外部时钟时称为计数器模式(Counter Mode)。选择外部时钟时,计数时钟的边沿可进行选择。

#### 5. 2 TIMER1 模块

TIMER1 是一个 16 位的定时器/计数器,由两个 8 位可读写的寄存器 (TIMER1H和TIMER1L)组成。CPU可对TIMER1 寄存器 (TIMER1H和TIMER1L)进行读写操作。TIMER1 寄存器的计数值从 0000<sub>H</sub>递增到FFFF<sub>H</sub>,然后再回到 0000<sub>H</sub>。

#### 5. 3 TIMER2 模块

TIMER2 是一个 8 位的定时器,包括一个 4 位可编程预分频器和一个 4 位可编程后分频器。CPU 可对 TIMER2 寄存器进行读写操作。TIMER2 寄存器存放计数值。TIMER2 可以作为 CCP 模块中的 PWM 功能的时基。

TIMER2 只能使用内部时钟源,时钟源频率为系统时钟 4 分频(即 Fosc/4)。CCP 模块设为 PWM 模块时,TIMER2 作为 PWM 的时基定时器。

## 6. CCP (捕捉/比较/脉宽调制) 模块

芯片有两路功能相同的 CCP 模块——CCP1 和 CCP2。它们都各自有两个 8 位 CCP 寄存器(CCPxH、CCPxL)和一个控制寄存器 CCPxCON。

CCP 模块有三种工作模式: 捕捉模式、比较模式和脉宽调制模式。

### 7. 模/数转换器 ADC 模块

芯片 HR6P77 带有一个 8 位 A/D 转换模块, 此模块能将一个模拟信号转换成相对应的 8 位数据。芯片有 8 个 A/D 通道模拟输入端。

## 8. 高速同步/异步接收发送器模块 HUSART

高速同步/异步接收发送器 HUSART,也叫串行通信接口 HSCI。异步/同步模式分别为全/半双工模式。全双工是指同一时刻既可发又可收。半双工是指同一时刻不可能既发又收,收发是时分的。

14/26

网址: http://www.ichaier.com/



## 9. 指令集系统

HR6P77 提供了 48 条精简指令。汇编指令只是为了方便程序设计者使用,因此指令名称大多是由指令功能的英文缩写所组成的。这些指令所组成的程序经过编译器的编译与连接后,会被转换为相对应的指令码。转换后的指令码可以分为操作码(OP Code)与操作数(Operand)两个部分。操作码部分对应到指令本身。HR6P77 中的每一条指令宽度都是 16 位,指的就是操作码加上操作数后的位宽度,也就是指令码宽度为 16 位。

除了部分条件跳转与控制流程的指令需要两个机器周期来完成,包括 MUL、CALL、GOTO、RET、RETIE、RETIA、LCALL、JUMP 以及条件满足时的 JBS 和 JBC 指令,其他指令的执行都是在一个机器周期中完成。。单片机运行在 4MHz 振荡时钟时,一个机器周期的时间为 1μs。

下表为 HR6P77 的指令集。

	指令	指令	<b>冷码</b>	状态位	说明
ADD	R, F	s1 1010 11	frrr rrrr	C, DC, Z	将A和R相加
AND	R, F	s1 1010 01	frrr rrrr	Z	A和R"与"操作
CLR	R	s1 1011 01	1fff rrrr	Z	对 R 清 0
CLRA		s1 1011 01	0000 0011	Z	对 A 清 0
COM	R, F	s1 1001 01	frrr rrrr	Z	求R的补码
DEC	R, F	s1 1011 11	frrr rrrr	Z	R减1操作
JDEC	R, F	s1 1001 11	frrr rrrr		R减1操作, 若为0跳
INC	R, F	s1 1001 10	frrr rrrr	Z	R加1操作
JINC	R, F	s1 1000 11	frrr rrrr		R加1操作,若为0跳
IOR	R, F	s1 1010 00	frrr rrrr	Z	A与R或
MOV	R, F	s1 1001 00	frrr rrrr	Z	传送 R
MOVA	R	s1 1011 00	1fff rrrr		将A送至R
NOP		s1 1011 00	0000 0xx0		空操作
RL	R, F	s1 1000 01	frrr rrrr	С	R寄存器带进位左循环
RR	R, F	s1 1000 00	frrr rrrr	С	R 寄存器带进位右循环
SUB	R, F	s1 1011 10	frrr rrrr	C, DC, Z	R 减 A
SWAP	R, F	s1 1000 10	frrr rrrr		R 半字节交换
XOR	R, F	s1 1010 10	frrr rrrr	Z	A 与 R 异或
NOP2		s1 111x xx	xxxx xxxx		空操作
NOP3		s0 0000 0x	xxxx xxxx		空操作
DAW		s0 0001 00	xxxx xxxx	C, DC, Z	对 A 进行 BCD 码调整
DAR	R, F	s0 0001 01	frrr rrrr	C, DC, Z	对 R 进行 BCD 码调整

网址: http://www.ichaier.com/



## 【续】

_	指令	指令码	状态位	说明
ADDC	R, F	s1 1101 0x frrr rrrr	C, DC, Z	带进位加
SUBC	R, F	s1 1101 1x frrr rrrr	C, DC, Z	带借位减
MOVAB	F	s1 1100 1x fxxx xxxx		B与A传送
MUL	R, F	s1 1100 01 frrr rrrr	Z	R与A相乘
BCC	R, B	s1 0011 bb brrr rrrr		清 R 的第 bbb 位
BSS	R, B	s1 0010 bb brrr rrrr		置R的第bbb位
JBC	R, B	s1 0001 bb brrr rrrr		测试 R 的第 bbb 位, 为 0 跳
JBS	R, B	s1 0000 bb brrr rrrr		测试 R 的第 bbb 位, 为 1 跳
ADDI	Ι	s1 0100 1x iiii iiii	C, DC, Z	立即数加 A
ANDI	Ι	s1 0101 01 iiii iiii	Z	立即数与 A 相 "与"
CALL	Ι	s0 001i ii iiii iiii		调用子程序
CWDT		s1 1011 00 0110 0100		看门狗清0
GOTO	Ι	s0 010i ii iiii iiii		跳转
IORI	Ι	s1 0101 00 iiii iiii	Z	立即数与A或
MOVI	Ι	s1 0111 xx iiii iiii		立即数移至 A
RETIE		s1 1011 00 0000 1001		中断返回
RETIA	Ι	s1 0110 xx iiii iiii		立即数送 A 子程序返回
RET		s1 1011 00 0000 1000		从子程序返回
IDLE		s1 1011 00 0110 0011		进入休眠状态
SUBI	Ι	s1 0100 0x iiii iiii	C, DC, Z	立即数减 A
XORI	Ι	s1 0101 10 iiii iiii	Z	立即数与 A 相异或
ADDCI	Ι	s0 0000 10 iiii iiii	C, DC, Z	立即数带进位加
SUBCI	Ι	s0 0000 11 iiii iiii	C, DC, Z	立即数带借位减
LCALL	I	s0 liii ii iiii iiii		长地址调用子程序
JUMP	Ι	s1 1100 00 iiii iiii		短地址跳转
MULI	Ι	s0 0001 1x iiii iiii	Z	立即数乘法

注: s-加密位,x-任意,i-立即数,r-寄存器,b-某位,f-标志位,A-寄存器 A,B-寄存器 B,R-寄存器 R。



#### 10. CPU 特性

## 10. 1 低功耗休眠 IDLE 状态

软件通过执行一条指令IDLE,即可使得微控制器进入休眠状态。进入休眠状态之后,外部振荡器停止振荡,所有I/O端口将保持进入IDLE前的状态,把所有的I/O引脚放在 $V_{DD}$ 或 $V_{SS}$ 电平上,以保证外部电路不从I/O引脚消耗电流。

芯片可通过以下事件把微控制器从休眠状态唤醒:

- ◆ 在MRST 端口上施加一个有效低电平
- ◆ PB 口高四位电平改变引起中断
- ◆ 在异步计数器方式下的 TIMER1 溢出中断
- ◆ PB0/INT 信号沿跳变中断
- ◆ 从动模式, HSPI 发送、接收完数据中断
- ◆ HIIC 主控和主从方式下,检测到启动和停止信号产生中断
- ◆ HIIC 从动发送、接收完数据中断
- ◆ HSCI 同步从动接收、发送完数据中断

#### 10.2 中断逻辑

HR6P77 共有 14 个中断源,其中断向量对应于  $0004_H$ 、 $000D_H$ 和  $0021_H$ ,通过中断子程序中判断各中断源的中断标志位及中断使能位可判断是由哪个中断源引起的中断,从而执行相应的中断服务子程序。

中断现场保护是中断程序中一个很重要的组成部分。由于指令系统中没有 PUSH(压栈)和 POP(出栈)指令,所以只能用其他指令实现数据保存。通常需要保存的数据包括:工作寄存器 A,状态寄存器 STATUS 和需要保存的用户数据寄存器。

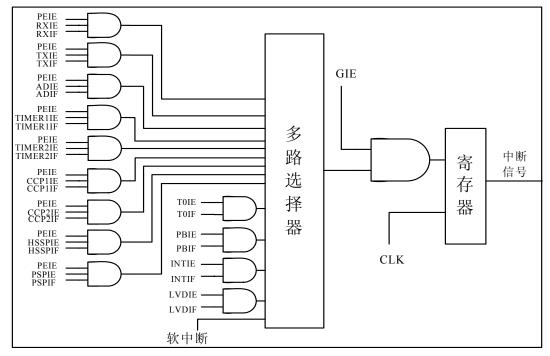


图 10.1 中断逻辑



#### 10.3 复位

- ◆ 上电复位 POR
- ◆ 掉电锁定复位 BOR
- ◆ 正常运行时通过外部端口 MRST 加低电平复位
- ◆ 在 WDT 使能的运行状态下看门狗 WDT 超时复位

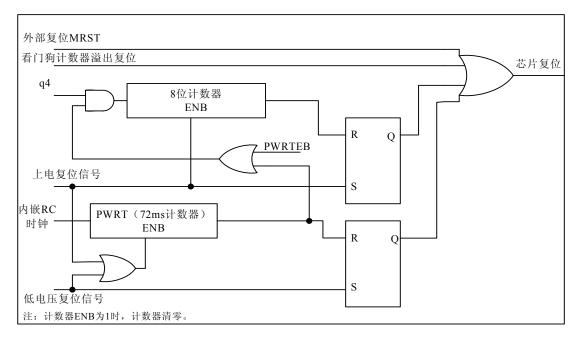


图 10.2 芯片复位原理图

电话: +86-21-64572211 网址: http://www.ichaier.com/



# 11. DC 参数特性

# ◆ 最大标称值(V<sub>SS</sub> = 0V)

参数	符号	条件	标称值	单位
电源电压	$V_{ m DD}$	1	$-0.3 \sim 7.5$	V
输入电压	$V_{\rm IN}$		$-0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
输出电压	$V_{OUT}$	_	$-0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
存储温度	$T_{STG}$	_	<b>−</b> 55 ~ 125	${\mathbb C}$
操作温度	$T_{OPR}$		<b>−</b> 40 ~ 85	${\mathbb C}$

# ◆ 芯片直流特性表

## ◇ 芯片功耗特性参数表

	芯片工作温度范围: -40℃~85℃									
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	工作条件				
芯片供电电压	$V_{DD}$	3.5	_	5.5	V	全V <sub>DD</sub> 范围				
芯片静态电流	$I_{DD}$	_	300	1000	uA	上电复位, $V_{DD} = 5V$ , 所有的 $I/O$ 输入高电平, $\overline{MRST} = 0$ ,OSC1 高 电平,OSCO不接负载。				
休眠模式下芯片电流	$I_{PD}$	_	_	6.0	mA	V <sub>DD</sub> = 5V, 进入休眠模 式, WDT不使能。				
正常运行模式芯片电流	$I_{OP}$		_	20.0	mA	V <sub>DD</sub> = 5V, 正常运行模 式,4MHz时钟输入,输 出I/O端口不接负载。				
V <sub>DD</sub> 管脚的最大输入电流	$I_{MDD}$	_	150	_	mA	$V_{DD} = 5V$				
Vss管脚的最大输出电流	$I_{MSS}$	_	200	_	mA	$V_{DD} = 5V$				
输出电流 (每个端口)	$I_{O}$		35	_	mA	$V_{DD} = 5V$				



# ◇ 芯片输入端口特性表

	芯片工作温度范围: -40℃~85℃									
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件				
I/O 端口 输入高电平		2.0	-	$V_{DD}$	V					
主复位信号 MRST 输入高电平(有施 密特输入特性)	$V_{\mathrm{IH}}$	$0.8 \mathrm{V}_\mathrm{DD}$	I	$ m V_{DD}$	V	$3.5V \leqslant V_{DD} \leqslant 5.5V$				
I/O 端口 输入低电平	V	$ m V_{SS}$	1	0.8	V					
主复位信号 MRST 输入低电平	$ m V_{IL}$	$V_{\mathrm{SS}}$	-	$0.2V_{DD}$	V					
I/O 端口 输入漏电流	ī	-	-	<u>+</u> 1	μА	3.5V≤V <sub>DD</sub> ≤5.5V (端口处于高阻状态)				
主复位信号、 MRST 漏电流	$ m I_{IL}$			5	μА	$V_{SS} \leqslant V_{PIN} \leqslant V_{DD}$				
PB 输入 弱上拉电流	$I_{PUPB}$	30	100	200	μА	$3.5V \leqslant V_{DD} \leqslant 5.5V$ $V_{PIN} = V_{SS}$				

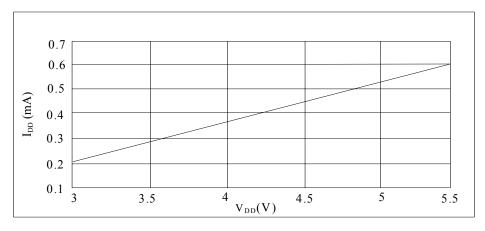
## ◇ 芯片输出特性参数表

芯片工作温度范围: -40℃~85℃										
参数	符号	最小值	典型值	最大值	単位	测试条件				
I/O 端口输出	$V_{\mathrm{OH}}$	$V_{DD} = 0.7$	_		V	$3.5V \leqslant V_{DD} \leqslant 5.5V$				
高电平	VOH	V DD O.7			v	$I_{OH} = 3.0 \text{mA}$				
I/O 端口输出	17			0.6	17	$3.5V \leq V_{DD} \leq 5.5V$				
低电平	$V_{OL}$	_	_	0.6	v	$I_{OL} = -8.5 \text{mA}$				

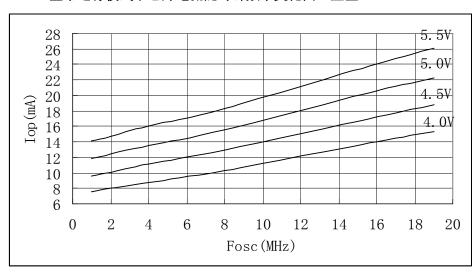


## ◆ 芯片直流特性图

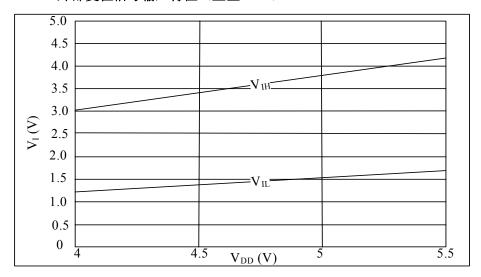
■ 芯片静态电流随芯片电压变化图(室温 25℃)



■ 正常运行模式下芯片电流随时钟频率变化图(室温 25℃)



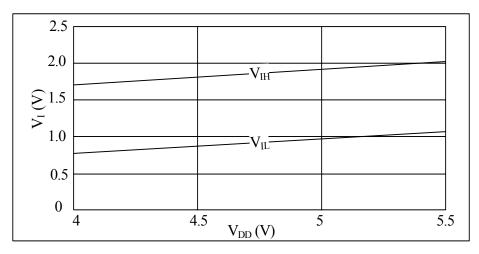
■ 外部复位信号输入特性(室温 25℃)



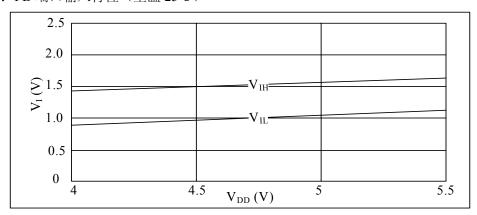


## ■ I/O 端口信号输入特性

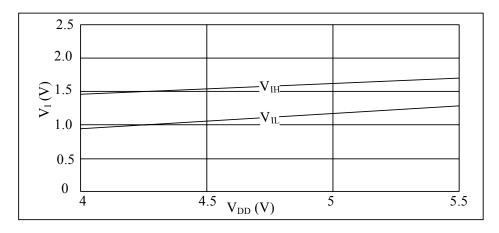
A: PA、PE 端口输入特性(室温 25℃)



B: PB 端口输入特性(室温 25℃)



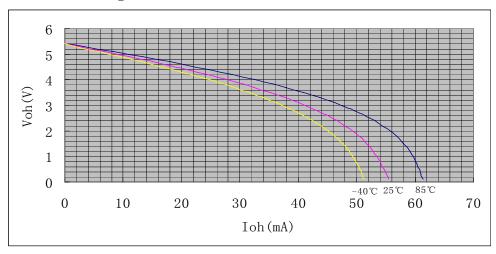
C: PC、PD 端口输入特性(室温 25℃)



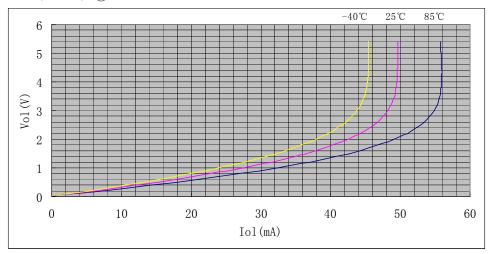


## ■ I/O 端口输出特性

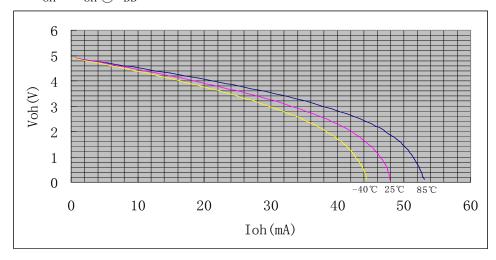
A:  $V_{OH} \text{ vs. } I_{OH} @ V_{DD} = 5.5 V$ 



B:  $V_{OL}$  vs.  $I_{OL}$  @ $V_{DD}$  = 5.5V

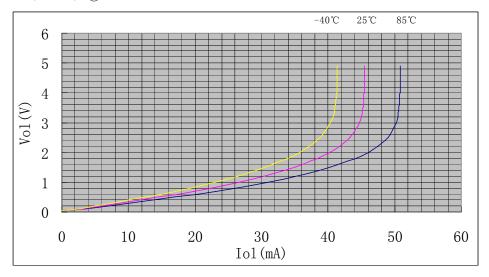


C:  $V_{OH} \text{ vs. } I_{OH} @ V_{DD} = 5.0 \text{ V}$ 

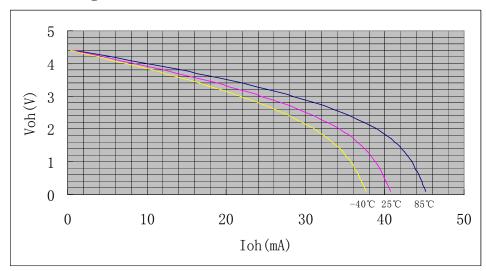




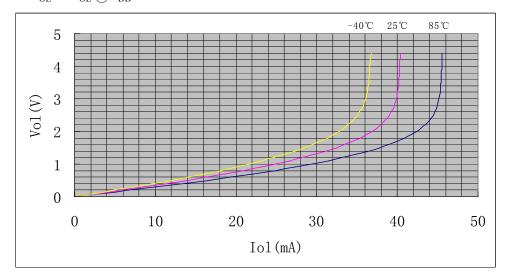
## D: $V_{OL} \text{ vs. } I_{OL} @ V_{DD} = 5.0 \text{V}$



## E: $V_{OH}$ vs. $I_{OH}$ @ $V_{DD}$ = 4.5V



F:  $V_{OL}$  vs.  $I_{OL}$  @ $V_{DD}$  = 4.5V





# 12. AC 参数特性

## 12. 1 时钟要求

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
外部时钟频率	Fosc	DC		16M	Hz	高速振荡模式
时钟振荡频率		32K		16M	Hz	振荡模式
机器周期	T <sub>INST</sub>	250		DC	ns	$T_{INST} = 4/F_{OSC}$
外部时钟高电平 和低电平时间 <sup>注</sup>	T <sub>OSL</sub> , T <sub>OSH</sub>	15	ı	I	ns	高速振荡模式
外部时钟上升 和下降时间 <sup>注</sup>	T <sub>OSR</sub> , T <sub>OSF</sub>			15	ns	高速振荡模式

注:此参数为设计值。

## 12. 2 ADC 交流特性

参数名称	最小值	典型值	最大值	単位
分辨率	_	_	8	bit
差分线性度(DNL)	_	_	±1	LSB
积分线性度(INL)	_	_	±1	LSB
失调误差 (Offset Error)	_	_	1	LSB
参考电压范围(V <sub>REF</sub> )	3.5	_	V <sub>DD</sub> +0.3	V
模拟电压输入范围(Vin)	0	_	$V_{REF}$	V
输入电容	_	10	_	pF
模拟输入推荐输入电阻	_	_	10K	Ω
转换时钟周期(Tad)	1.5		_	μs

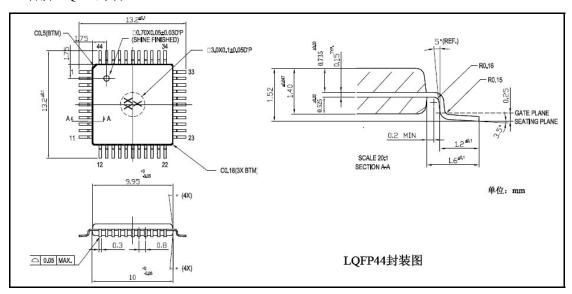
ADC 时钟源			工作频率					
选择	ADCS1	ADCS0	16MHz	8MHz	4MHz	1MHz		
Fosc/2	0	0	1.375µs <sup>注</sup>	2.75μs <sup>注</sup>	5.5μs <sup>注</sup>	22μs		
Fosc/8	0	1	5.5μs <sup>注</sup>	11μs <sup>注</sup>	22μs	88µs		
Fosc/32	1	0	22μs	44µs	88µs	352μs <sup>注</sup>		
Frc	1	1	24-78μs <sup>注</sup>					

注:该设置不推荐使用。



## 13. 芯片封装

## 44 管脚 LQFP 封装



## 40 管脚 DIP 封装

